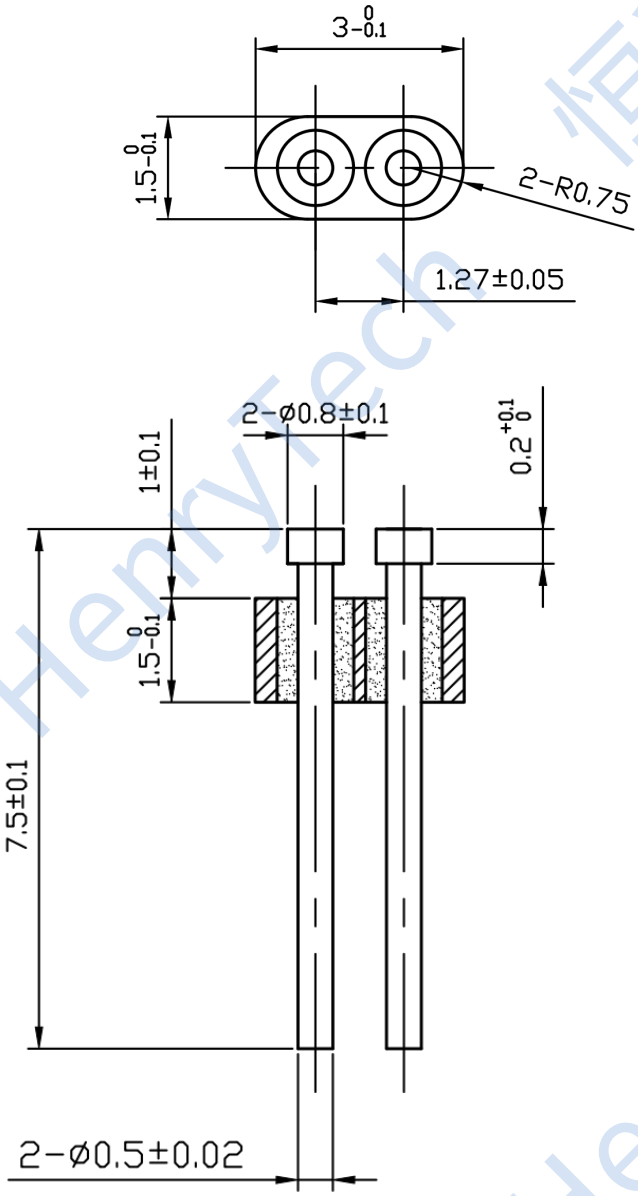


**技术要求：**

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10$^{-3}$Pa · cm$^{3}$ /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借通用件登记 | | | | | | |
| 描 图 | | | | | | |
| 校 描 | | | | | | |
| 旧底图总号 | | | | | | |
| 签 字 | | | | | | |
| 日 期 | | | | | | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 装配图 | HN-LP2-0.5-1.27(7.5-1)-T0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | M | 标准化 | | | 图样标记 / 重量 / 比例 | 成都恒利泰科技有限公司 |
| 审核 | | | | | 10:1 | 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |
| 工艺 | | 日期 | | | 共 页 / 第 页 | |

恒利泰 HenryTech